

**性能特点：**

- 频带：18~40GHz
- 插入损耗：0.8dB
- 插损波动：±0.2dB
- 隔离度：25dB
- 输入/输出电压驻波比：1.2/1.1
- 芯片尺寸：1.67mm×1.4mm×0.075mm

**产品简介：**

HH-PD1840V 是一款 GaAs MMIC 0°两路功分器芯片，该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成等特点，其频率范围覆盖 18~40GHz。

**电参数：** (T<sub>A</sub>=25°C)

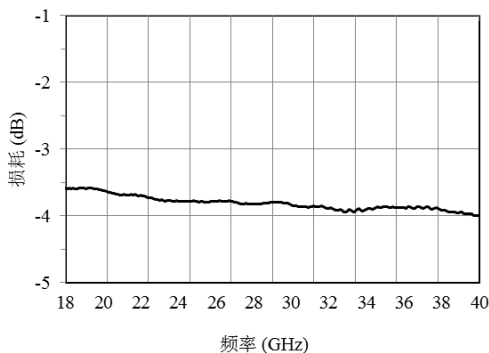
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	18~40			GHz
插入损耗	0.6	0.8	1.0	dB
插损波动	-	-	±0.2	dB
隔离度	22	25	-	dB
输入驻波比	-	1.2	1.4	-
输出驻波比	-	1.1	1.3	-

**使用限制参数：** (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

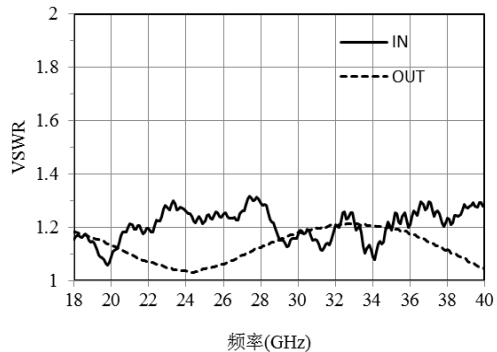
输入功率	+37dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

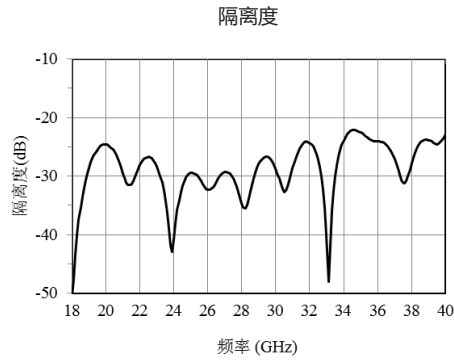
**典型曲线：**

插入损耗

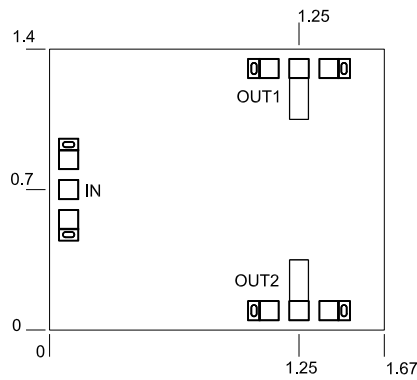


输入输出驻波比

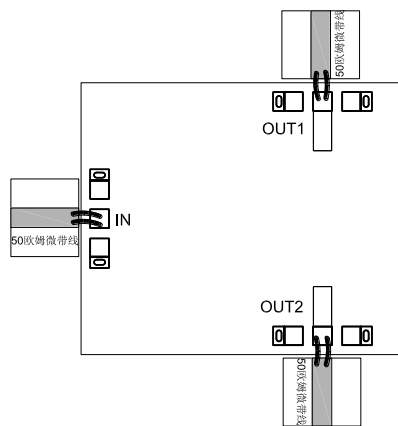




尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



**使用说明：**

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。